

6-535542-0 ✓ AKTIV

AMPMODU | Modu Connector System

Interne TE-Nummer 6-535542-0

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 20 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Modu Connector System

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Buchse für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **20**

Zeilenanzahl: **2**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Aufgebrachter Druck	Standard
PCB-Steckverbindermontagetyp	Buchse für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	20
Zeilenanzahl	2
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	750 VAC
Isolierwiderstand	5000 MΩ
Arbeitsspannung	333 VAC

Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Niedrig
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Kontaktmerkmale

Kontaktschutztyp	Geschlossenes Eingangsgehäuse
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
	10 µin
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.762 µm[30 µin]
Kontakttyp	Stecksockel
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.2 mm[.008 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.7 mm[.028 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3.3 mm[.13 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlussstechnik

Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Steckeingangsposition	Boden und Oberseite
Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Polyester – GF

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	5.03 mm[.198 in]
Reihenabstand	2.54 mm, 3.81 mm[.15 in]
Stapelhöhe	9.02 mm[.355 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.055 – .094 in]

Verwendungsbedingungen

Gehäusenenn-temperatur	Standard
------------------------	----------

Betriebstemperaturbereich	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	22
Verpackungs-Typ	Kasten, Rohr

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

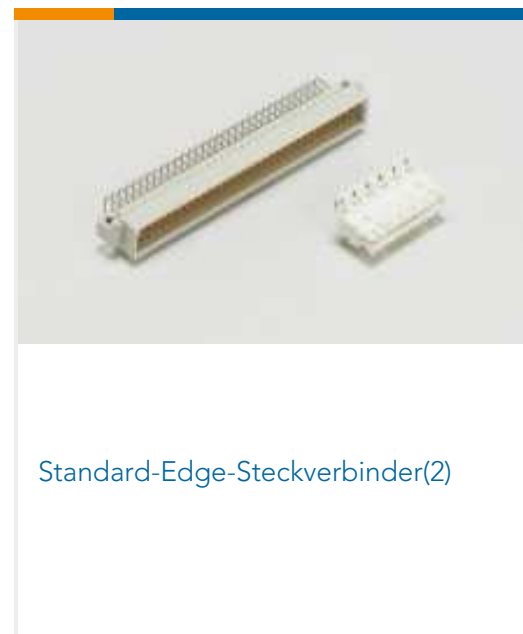
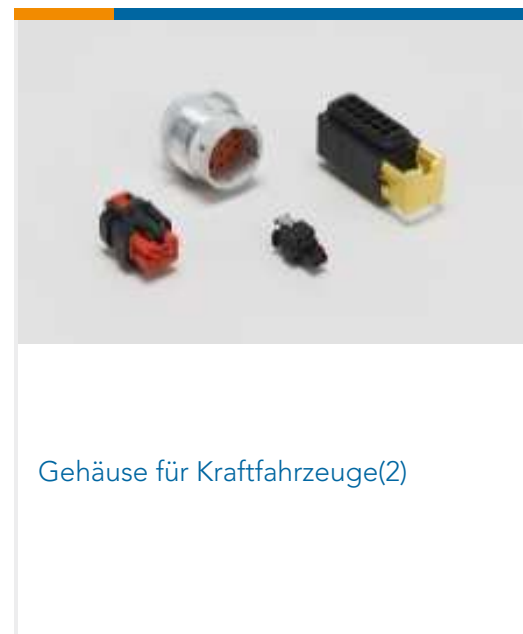
Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | Modu Connector System



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-535542-0_W.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-535542-0_W.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-535542-0_W.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch